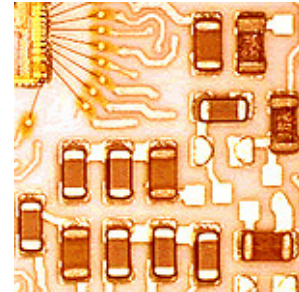


## 环氧树脂导电粘合剂 Epoxy Based Electrically Conductive Adhesives

本公司出产两大类导电粘合剂 (ECA)，一类以银粉为填料，有机硅树脂为基体 (Silductor 系列)，另一类以银粉为填料，以环氧树脂为基体 (Eposolder 系列)，制成单组分和双组分。它们既可用于滴注，也可用于筛孔式 (screen) 或镂空式 (stencil) 模板印刷。本页所列的 Eposolder 系列导电粘合剂能与常规金属或合金的表面形成优良的粘接力，同时保持高度的导电和导热性。

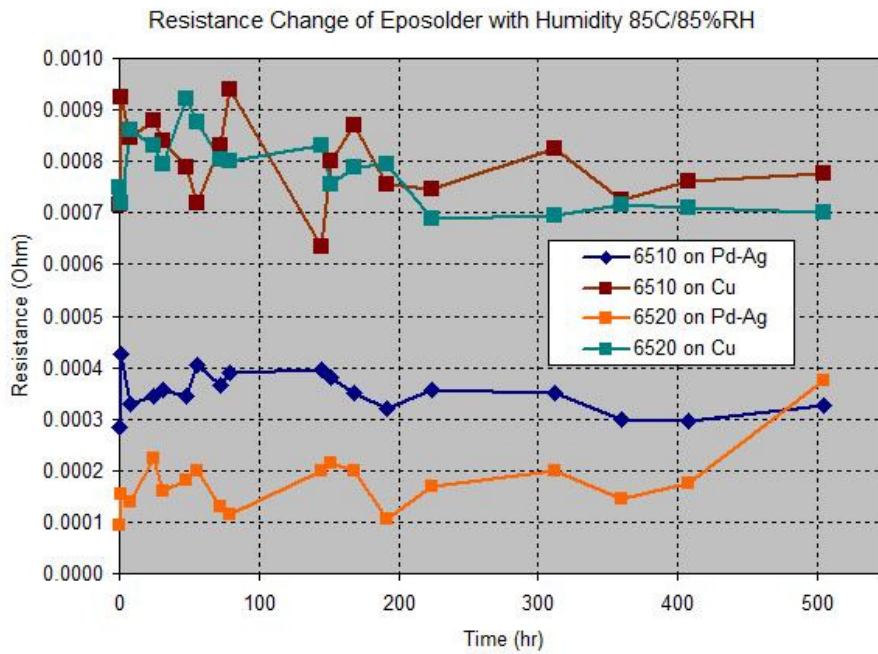
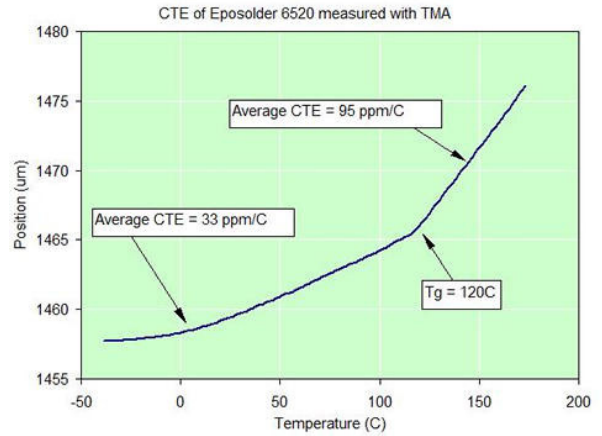
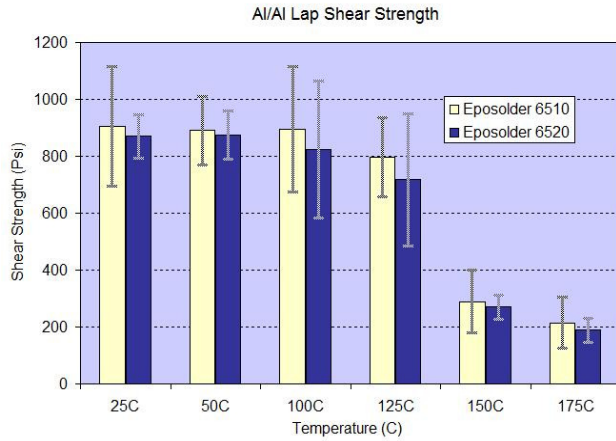


### 【应用领域】

导电粘合剂可广泛应用于在较低温度或常温下的元器件的焊接，从而取代焊锡。为低温表面安装，以及热敏元器件的安装提供有效的解决方法。此类应用包括传感器、磁盘驱动器中的构件的安装，flip-chip，芯片，模块，整套件，MEMS，LED 驱动器的 IC，CCD 芯片，晶片，CSP，等等的表面安装或包装。导电粘合剂为此类电子器件提供了优良的导电和导热界面。

产品名称 Name	Eposolder 6510	Eposolder 6512	Eposolder 6520	Eposolder 6760
化学基础 Chemical Base	环氧树脂 / 银	环氧树脂 / 银	环氧树脂 / 银	柔性环氧树脂 / 银包铜
特点 / 优点 Features / Advantages	单组分可滴注. 高导电和导热性. 不含溶剂. 强粘合力.	双组分. 可滴注. 可室温固化. 高导电和导热性.	单组分可滴注. 可印刷. 高导电和导热性. 低脱气. 单组分. 无溶剂. 强粘合力.	可用于筛孔式或镂空式模板印刷. 高导电和导热性. 低脱气. 单组分. 无溶剂. 强粘合力.
应用范围 Typical Application	用于电子元器件, 芯片, 模块, 晶片等的低温焊接, 电路印刷, 电路导通, 接地连结, EMI / RFI 的屏蔽等.	用于电子元器件, 芯片, 模块, 晶片等的低温焊接, 电路印刷, 电路导通, 接地连结, EMI / RFI 的屏蔽等.	用于电子元器件, 芯片, 模块, 晶片等的低温焊接, 电路印刷, 电路导通, 接地连结, EMI / RFI 的屏蔽等.	用于电子元器件, 芯片, 模块, 晶片等的低温焊接, 电路印刷, 电路导通, 接地连结, EMI / RFI 的屏蔽等.
流变性 Rheology	Dispensable Printable	Dispensable	Dispensable and Printable	Printable
组分 Part / Component	One	Two	One	One
粘度 Viscosity (25C, cps)	35,000	34,000	52,000	38,000
触变指数 Thixotropic Index (0.5 / 5 rpm)	3.2	3.5	4.2	3.5
密度 Density (g/ml)	4.6	4.3	4.6	1.8
操作处理时限 Work life (hr)	24	15 min	32	24
固化速度 Cure Rate	85C 60 min 125C 60 min	rtT 8 hrs 125C 15 min	125C 60 min 150C 30 min	125C 30 min
储存条件 Storage	-40 C	< 25C	-40 C	-40 C
储存寿命 Shelf Life (days)	6 month @ -40C	12 month @ < 25C	6 month @ -40C	6 month @ -40C
热稳定性 Thermal Stability	-40C to 180C	-40C to 150C	-40C to 180C	-50C to 230C
玻璃转化温度 Tg	65 C	~ 120 C	125 C	~ 75 C
热膨胀系数 CTE (ppm/C)	<110 (above Tg) <40 (below Tg)	<140	<100 (above Tg) <35 (below Tg)	< 210
硬度 Hardness (ASTM D2240)	Shore D = 78	Shore D = 75	Shore D = 85	Shore A = 45
电阻率 Volume Resistivity (Ohm-cm)	< 2x10 <sup>-4</sup>	< 2x10 <sup>-4</sup>	< 2x10 <sup>-4</sup>	< 3x10 <sup>-3</sup>
粘合力 Adhesion (Al/Al Lap Shear, psi)	Strong > 1200 psi	Strong > 800 psi	Strong > 1000 psi	Strong > 400 psi
热导系数 Thermal Conductivity (W/mK)	>5	>5	>5	> 3.5

► **Mechanical and Electrical Properties of Eposolder ECAs**



4-points probe resistance measurement

